



Инструкция по применению: действительна для Великобритании



Клей:

DLW Vinyl Токопроводный материал

DLW Vinyl ESD

Клей на водной основе

Thomsit K112
In combination with Thomsit R762 Conductive Base Coat

Thomsit K112 (*) Thomsit K113
In combination with Thomsit R762 Conductive Base Coat

*) Dependent of the characteristics of the flooring material and the maximum flooring resistant.

Подготовка основания для следующих видов напольных материалов:

Тип основания	Нивелирующая смесь на гипсовой основе	Цементная стяжка	Бетон
Допускаемая остаточная влажность	≤ 0,5 % (CM)	≤ 2,0 % (CM)	Не должно быть подтеков под основание.
Подготовка основания Последовательность процедур	sand down brush vacuum off	brush vacuum off	brush vacuum off blast or mill vacuum off
Праймер Грунтовка на водной основе: Эпоксидная грунтовка:	 Thomsit R766 or R777	 Thomsit R766 or R777 Thomsit R755	 Thomsit R755 twice primed, plus fire-dried quartz sand grain size 0,3 - 0,7 mm; at least 2 kg/m ²
Нивелирующая масса Толщина слоя: мин. 2 мм	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85

Эти рекомендации были разработаны в качестве стандарта для новых зданий и сооружений В некоторых случаях возможны исключения Henkel AG & Co. KGaA. Необходимо провести дополнительные консультации www.Thomsit.com. Необходимо проконсультироваться с производителем Производитель отвечает за использование всех ресурсов в соответствии с условиями применения.

Сентябрь 2008



Инструкция по применению: действительна для Великобритании



Клей:

DLW Vinyl Токопроводный материал

DLW Vinyl ESD

Клей на водной основе

Ultrabond Eco V4 Conduttivo

Ultrabond Eco V4 Conduttivo

Подготовка основания для следующих видов напольных материалов:

Тип основания	Нивелирующая смесь на гипсовой основе	Цементная стяжка	Бетон
Допускаемая остаточная влажность	≤ 0,5 % (CM)	≤ 2,0 % (CM)	≤ 6 Weight %
Подготовка основания Последовательность процедур	кисть пылесос	кисть пылесос	кисть продувка или фрезеровка пылесос пылесос дробеструйная очистка
Праймер Грунтовка на водной основе: Эпоксидная грунтовка:	Primer G	Primer G	Primer MF нанести грунтовку в 2 слоя и посыпать второй влажный слой грунтовки сухим кварцевым песком
Нивелирующая масса Толщина слоя: мин. 2 мм	Ultraplan	Ultraplan	Ultraplan

Эти рекомендации были разработаны в качестве стандарта для новых зданий и сооружений В некоторых случаях возможны исключения Mapei GmbH. Необходимо провести дополнительные консультации www.mapei.com. Необходимо проконсультироваться с производителем Производитель отвечает за использование всех ресурсов в соответствии с условиями применения.

Сентябрь 2008



Инструкция по применению:
действительна для Великобритании



Фиксатор:

DLW Vinyl Токопроводный материал

DLW Vinyl ESD

Фиксатор на водной основе

UZIN KE 2000 SL

UZIN KE 2000 SL

Подготовка основания для следующих видов напольных покрытий:

Тип основания	Нивелирующая смесь на гипсовой основе	Цементная стяжка	Бетон
Допускаемая остаточная влажность	≤ 0,5 % (СМ)	≤ 2,0 % (СМ) подтока влаги из основания.	
Подготовка основания Последовательность процедур	шлифовать обеспылить	шлифовать обеспылить	шлифовать или дробеструить обеспылить
Праймер Грунтовка на водной основе:	UZIN PE 360	UZIN PE 360	UZIN PE 360
Эпоксидная грунтовка:		UZIN PE 460 с посыпкой грунтовки после нанесения сухим кварцевым песком фракций 0,3-0,7 мм	UZIN PE 460 с посыпкой грунтовки после нанесения сухим кварцевым песком фракций 0,3-0,7 мм
Нивелирующая масса Толщина слоя: мин. 2 мм	UZIN NC 170	UZIN NC 170	UZIN NC 170

Эти рекомендации были разработаны в качестве стандарта для новых зданий и сооружений В некоторых случаях возможны исключения Uzin Utz AG. Необходимо провести дополнительные консультации www.uzin-utz.com. Необходимо проконсультироваться с производителем Производитель отвечает за использование всех ресурсов в соответствии с условиями применения.